

Title (en)
METHOD FOR POLISHING SEMICONDUCTOR WAFERS ON BOTH SIDES BETWEEN A LOWER POLISHING PLATE AND AN UPPER POLISHING PLATE

Title (de)
VERFAHREN ZUM BEIDSEITIGEN POLIEREN VON HALBLEITERSCHEIBEN ZWISCHEN EINEM UNTEREN POLIERTELLER UND EINEM OBEREN POLIERTELLER

Title (fr)
PROCÉDÉ DE POLISSAGE DE CHAQUE CÔTÉ DE TRANCHE DE SEMI-CONDUCTEUR ENTRE UNE MOLETTE DE POLISSAGE INFÉRIEURE ET UNE MOLETTE DE POLISSAGE SUPÉRIEURE

Publication
EP 4000802 A1 20220525 (DE)

Application
EP 20207967 A 20201117

Priority
EP 20207967 A 20201117

Abstract (de)
Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiterscheiben zwischen einem unteren Polierteller und einem oberen Polierteller, umfassenddas Befeuchten eines unteren und eines oberen Poliertuchs mit einer Flüssigkeit;das Bekleben des unteren Poliertellers mit dem befeuchteten unteren Poliertuch;das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den unteren Polierteller;das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem befeuchteten oberen Poliertuch;das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den oberen Polierteller;das Pressen der Poliertücher gegeneinander;das Ablegen von Halbleiterscheiben auf dem unteren Polierteller; unddas beidseitige Polieren von Halbleiterscheiben mit dem oberen Poliertuch und dem unteren Poliertuch in Gegenwart eines Poliermittels.

IPC 8 full level
B24B 1/00 (2006.01); **B24B 37/08** (2012.01); **B24B 37/28** (2012.01); **H01L 21/02** (2006.01)

CPC (source: EP)
B24B 37/08 (2013.01); **B24B 37/28** (2013.01)

Citation (applicant)

- US 2003054650 A1 20030320 - WENSKI GUIDO [DE], et al
- DE 10007390 A1 20001012 - WOLTERS PETER WERKZEUGMASCH [DE]
- US 2007087671 A1 20070419 - NAKAMURA YOSHIO [JP], et al
- JP 2006289523 A 20061026 - SPEEDFAM CO LTD
- JP 2006346808 A 20061228 - MIMASU SEMICONDUCTOR IND CO
- DE 10239774 A1 20031127 - WACKER SILTRONIC HALBLEITERMAT [DE]
- DE 102017217490 A1 20190404 - SILTRONIC AG [DE]

Citation (search report)

- [Y] JP 2007313587 A 20071206 - SUMCO TECHXIV CORP
- [YD] US 2007087671 A1 20070419 - NAKAMURA YOSHIO [JP], et al

Cited by
EP4306262A1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 4000802 A1 20220525

DOCDB simple family (application)
EP 20207967 A 20201117